

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20180613

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	中金公司 张梓丁 菁英时代基金 郑伟 菁英时代基金 洪泽宇 新百信基金 刘霄 海通证券 耿耘
时间	2018年6月13日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书宋天玺
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书宋天玺先生接受机构投资者提问： 1、公司 SMT 业务 2017 年增长的主要原因是什么？ 2017 年公司业绩较去年同期及行业增速增长明显，主要原因包括： 1) 行业因素：电子整机装联设备行业经竞争淘汰及产业整合后，公司发展成为国内少数规模较大的电子整机装联设备供应商之一，进一步促进了公司在电子整机装联设备细分领域市场份额的提升，目前公司主要参与国内焊接设备中高端市场的竞争，凭借公司在电子整机装联设备行业多年积累及良好品质口碑，公司产品在行业内具备话语权及定价权。 2) 市场因素：报告期内 3C 消费电子领域新工艺、新技术的出现以及 3C 电子产品的日趋快消化，带动公司下游生产厂商投资增设新产线或设立新工厂，进而增加公司电子整机装联设备采购量。同时报告期内公司适用于新工艺、新技术的

电子整机装联设备及光电模组生产专用设备陆续推向市场，满足了公司下游厂商的生产及技术升级需求。

3) 自身优势：以手机为代表的 3C 类消费电子的快消化，以及屏幕、机身材质、识别工艺、处理器等新技术新工艺的更新换代、5G 技术的推出等，都将促使消费电子市场景气度的不断提高及公司下游产线投资的不断增加。公司经过多年积累具备庞大客户群体、专业自主研发团队、全工序生产制造能力、标准化售后服务体系及良好品牌声誉等核心竞争力，同时公司作为行业内上市公司，具备资金及资源配置优势，能及时针对下游工艺技术变革制定相应措施并获得竞争先机，进而在行业竞争中获取更多的市场机会，提升市场份额。同时报告期内公司推出多款光电模组方面专用设备，并获得行业主流客户认可，为公司实现电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动、协同发展战略目标提供了铺垫。报告期内，高温垂直固化炉凭借其良好性能及高精密度，取得主流手机生产制造商及其上游企业的批量采购订单，全年实现销售收入 3,370.43 万元，成为公司新的业绩增长点。

2、目前 SMT 波峰焊回流焊行业前五大集中度分别是什么？一般下游厂商是不是会选择 2-3 家供应商，公司平均在下游客户中多少市场份额？

公司焊接设备前五大销售情况属于保密信息，目前 SMT 焊接设备行业集中度较高，且考虑到产品操作的便捷性，客户一般不会选择多家供应商。

3、AOI 目前情况是否像招股说明书中描述只有 20%-30% SMT 产线配置，且大多为炉后一台，这部分如果按照国际标准 SMT 产线全配，每条配三台大概有多少市场空间？

SMT 产线中的视觉检测设备是根据客户工艺和制程要求进行配置的，并无国际通用标准，目前一般是回流焊炉前配置一台 SPI、一台 AOI，回流焊炉后配置一台 AOI。

目前我司 AOI 设备包括离线 AOI 及在线 AOI，在线 AOI 更便于实现自动化生产，离线 AOI 则使用更加灵活。

4、公司目前在 SMT 产业链上还有什么新的延伸产品完成研发或者已经和客户小批量的么？

目前用于 PCB 裸板外观检测的 AVI 样机正在测试阶段，该产品为公司 AOI 设备在 SMT 产线的延伸产品。

同时，能全自动完成 PCB 板从涂覆助焊剂、预加热、锡焊及冷却等焊接全部工艺的全程氮气波峰焊也在研发测试阶段。应用于 SMT 表面贴装焊接的智能高效回流焊目前处于小批量试产阶段。

5、从产业角度，预计未来 5 年 SMT 行业的增速会是什么情

况？

SMT 行业增速受多方面因素影响，如国内经济景气度，国内外贸易开放程度及消费电子、汽车电子发展趋势等，故不好预测。

6、设备使用年限大概是多少？

公司产品的使用寿命，除了受自然使用寿命的影响，还受到下游工艺、技术变化的影响。下游客户在新投产线的时候，会综合考虑设备成本、维修保养成本、设备的售后维修设备的稳定性以及产品技术工艺要求等各方面影响因素，以确定是简单更新老设备还是采购新设备。

7、超声波指纹识别方面，如果下游手机厂商计划推出一款这种产品，一般提前多久采购设备？公司这部分有和客户接触了吗？这部分设备竞争对手主要是哪些？这个设备大概有多少空间？

公司超声波指纹模组封装设备已用于 VIVO X21 项目，同时该类产品方面目前已在接触客户包括华为、欧菲科技等。

8、摄像头模组生产设备是主要是供应欧菲光吗？采购占比是多少？

摄像头模组生产设备主要用于双摄和三摄产品的生产，欧菲只是我司其中一家客户，我司在欧菲的供应占比不能确定。

9、OLED 设备这边是什么情况？

我司 OLED 设备主要包括 OLED 模组封装设备系列及自动补偿设备 demura，OLED 模组封装设备系列目前已开始批量生产，自动补偿设备 demura 已完成客户端验证。

10、公司预计未来三年最看好的三个拳头产品是什么，目前分别处于什么进度（研发或给客户适配或小批量）？

新产品中我们目前比较看好屏下指纹模组封装设备、摄像头模组封装设备及 3D 玻璃设备，目前屏下指纹模组封装设备、摄像头模组封装设备处于批量销售阶段，3D 玻璃设备小批量试产。

11、除了 SMT 和光电领域，公司长期战略发展还有什么新的方向和布局么？

目前公司主要战略目标为实现电子整机装联设备与光电模组生产设备双轮驱动。

12、公司募投资项目现在进展如何？

公司募集资金投资项目将于 2018 年底达到预定可使用状态，现处于消防验收及外墙安装阶段。

13、对于焊接这部分有产能扩张计划吗？

公司将充分发挥公司在电子焊接细分市场的现有优势，持续提高公司在电子焊接板块的市场占有率。

	<p>14、公司高管减持方面现在进展如何？</p> <p>公司董事主逵先生股份减持计划已于 2018 年 5 月 22 日实施完毕，共减持 191.29 万股，减持均价 15.04 元。</p> <p>公司董事长吴限先生于 2017 年 12 月 14 日于巨潮资讯网发布《关于控股股东减持股份的预披露公告》，计划在 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 7 月 7 日期间减持公司股份不超过 200 万股，该减持计划结束时间为 2018 年 7 月 7 日。</p> <p>以上公司部分董事减持公司股票，主要系其个人临时资金需求，公司董事均在保证本次减持合法合规及满足相关规定基础上实施本次减持。</p>
附件清单（如有）	
日期	2018 年 6 月 13 日